平成25年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

平成26年2月14日

上場会社名 株式会社 SUMCO　　上場取引所　東
コード番号 3436　URL http://www.sumcosi.com/
代表者　(役職名) 取締役社長　(氏名) 橋本 眞幸
問合せ先責任者　(役職名) 広報・IR室長　(氏名) 澁谷 博史　TEL 03-5444-3915

定時株主総会開催予定日　平成26年3月28日　配当支払開始予定日　平成26年3月31日
有価証券報告書提出予定日　平成26年3月28日
決算補足説明資料作成の有無　：　有
決算説明会開催の有無　：　有　(機関投資家・証券アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成25年12月期の連結業績(平成25年2月1日～平成25年12月31日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年12月期	185,105	―	17,801	―	7,065	―	715	―
25年1月期	206,691	△16.4	13,215	―	9,464	―	3,426	―

(注)包括利益　25年12月期　16,281百万円　(―%)　25年1月期　8,552百万円　(―%)

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益	自己資本当期純利益率	総資産経常利益率	売上高営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
25年12月期	△1.22	―	0.4	1.4	9.6
25年1月期	8.93	―	2.6	2.0	6.4

(参考) 持分法投資損益　25年12月期　―百万円　25年1月期　―百万円

(注)当社は、平成25年4月25日に開催された定時株主総会で、「定款一部変更の件」が承認されたことを受け、平成25年度より1月31日の決算期を12月31日に変更いたしました。従いまして、経過期間となる平成25年12月期は平成25年2月1日から平成25年12月31日までの11ヶ月決算であるため、対前期増減率は記載しておりません。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
25年12月期	498,522	194,836	33.7	473.42
25年1月期	493,334	180,325	32.2	436.94

(参考) 自己資本　25年12月期　168,050百万円　25年1月期　158,746百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
25年12月期	2,341	△8,735	△4,513	62,863
25年1月期	16,308	△15,228	47,502	72,103

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額(合計)	配当性向(連結)	純資産配当率(連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
25年1月期	―	0.00	―	2.00	2.00	515	22.4	0.5
25年12月期	―	0.00	―	1.00	1.00	257	―	0.2
26年12月期(予想)	―	―	―	―	―		―	

(注)現時点において平成26年12月期の1株当たり配当金については未定であります。
(注)上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式(非上場)の配当の状況については、サマリー情報3ページの「(参考)A種種類株式の配当の状況」をご覧ください。

3. 平成26年12月期の連結業績予想(平成26年 1月 1日～平成26年12月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	102,000	―	9,000	―	6,500	―	4,500	―	15.28
通期	―	―	―	―	―	―	―	―	―

(注)当社グループが属する半導体業界は事業環境が短期間に大きく変化するという特徴があり、通期の業績予想について、現時点では合理的な予想を行うことが困難であることから、未定といたしました。なお、通期業績予想は合理的な予想が可能となった時点で速やかに開示いたします。詳細は、添付資料2ページの「1. 経営成績・財政状態に関する分析 (1)経営成績に関する分析」をご覧ください。
(注)当社は、平成25年12月期より決算日を1月31日から12月31日に変更しました。これに従い、当第2四半期累計期間(平成26年1月1日～平成26年6月30日)と前第2四半期累計期間(平成25年2月1日～平成25年7月31日)は、期間が異なるため対前年同四半期増減率を記載しておりません。

※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 ―社 (社名) 、 除外 ―社 (社名)
(注)詳細は、添付資料 7ページの「企業集団の状況」をご覧ください。

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
②①以外の会計方針の変更 : 無
③ 会計上の見積りの変更 : 無
④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	25年12月期	257,751,739 株	25年1月期	257,751,739 株
② 期末自己株式数	25年12月期	5,826 株	25年1月期	5,166 株
③ 期中平均株式数	25年12月期	257,746,136 株	25年1月期	257,746,762 株

(参考)個別業績の概要

平成25年12月期の個別業績(平成25年2月1日～平成25年12月31日)

(1) 個別経営成績 (%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年12月期	139,434	―	9,648	―	△380	―	△1,479	―
25年1月期	169,467	△18.3	9,751	288.4	7,087	973.5	9,038	―

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
25年12月期	△9.73	―
25年1月期	30.70	30.40

(注)当社は、平成25年4月25日に開催された定時株主総会で、「定款一部変更の件」が承認されたことを受け、平成25年度より1月31日の決算期を12月31日に変更いたしました。従いまして、経過期間となる平成25年12月期は平成25年2月1日から平成25年12月31日までの11ヶ月決算であるため、対前期増減率は記載しておりません。

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
25年12月期	456,645	160,864	35.2	445.54
25年1月期	456,824	160,554	35.1	443.96

(参考) 自己資本 25年12月期 160,864百万円 25年1月期 160,554百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料 2ページの「1. 経営成績・財政状態に関する分析 (1)経営成績に関する分析」をご覧ください。
(決算期についての特記事項)
当社は、平成25年4月25日に開催された定時株主総会で、「定款一部変更の件」が承認されたことを受け、平成25年度より1月31日の決算期を12月31日に変更いたしました。従いまして、経過期間となる平成25年12月期は、平成25年2月1日から平成25年12月31日までの11ヶ月決算となります。
(配当についての特記事項)
平成26年12月期の1株当たり配当金については未定としております。当該予想の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。詳細は、添付資料 3ページの「利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当」をご覧ください。
(決算説明資料の入手方法)
当社は平成26年2月14日に機関投資家・証券アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で使用する決算説明資料については、同日、当社ウェブサイトに掲載する予定です。

（参考）A種種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る1株当たり配当金の内訳は以下の通りです。

A種種類株式	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25年 1月期	―	―	―	2,500,000.00	2,500,000.00
25年12月期	―	―	―	2,287,671.23	2,287,671.23
26年12月期（予想）	―	―	―	―	―

（注）現時点において平成26年12月期の1株当たり配当金については未定であります。

【添付資料】

添付資料の目次

１．経営成績・財政状態に関する分析
（１）経営成績に関する分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 2
（２）財政状態に関する分析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 2
（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当・・・・・・・・・・・ P. 3
（４）事業等のリスク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 4

２．企業集団の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 7

３．経営方針
（１）会社の経営の基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 8
（２）中長期的な会社の経営戦略・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 8
（３）会社の対処すべき課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 8

４．連結財務諸表
（１）連結貸借対照表　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 9
（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書・・・・・・・・・・・・・・・ P.11
（３）連結株主資本等変動計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.13
（４）連結キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.15
（５）連結財務諸表に関する注記事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.16

５．その他
（１）役員の異動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.19

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

①当期の経営成績

当連結会計年度における半導体用シリコンウェーハ市場は、パソコン需要低迷の影響を受けたものの、スマートフォン・タブレットの需要拡大に牽引され、２月を底に回復基調で推移しました。

しかしながら、下期には、主力製品である300㎜ウェーハはスマートフォンのハイエンド品からローエンド品への急激なシフトが進み、これに伴うファウンドリーの生産調整の影響を受けました。また、小口径ウェーハは、主要用途であるパワー半導体・液晶ディスプレイドライバ向け等で、季節的な調整を受けました。

このような環境のもと、当社グループでは、「ＳＵＭＣＯビジョン」に基づき、製品の差別化のための技術開発とコスト低減を行い、市場環境の急変に柔軟に対応できるような体質変革を行ってまいりました。

＜SUMCO ビジョン＞

１．技術で世界一の会社

２．景気下降局面でも赤字にならない会社

３．社員が活き活きとした利益マインドの高い会社

４．海外市場に強い会社

以上の結果、当連結累計期間における当社グループの業績は、売上高 185,105 百万円、営業利益は 17,801 百万円、経常利益は 7,065 百万円となりました。また、特別損失として事業構造改善費用 2,672 百万円を計上した結果、当期純利益は 715 百万円となりました。

②次期の見通し

平成 26 年度上期のシリコンウェーハ市場は、昨年後半に始まった調整局面が終了し、スマートフォン・タブレットの需要に牽引され、回復局面に入ると予想しております。

このような市場見通しのもと、当社グループでは需要の増加を確実に取り込むとともに、コスト合理化を継続し、収益基盤を強化してまいります。

平成 26 年 12 月期の連結業績予想（第 2 四半期累計期間）につきましては、本決算短信（サマリー情報）の当該欄に記載の通りです。

なお、当社グループが属する半導体業界は事業環境が短期間に大きく変化するという特徴があり、通期の業績について、現時点では合理的な予想を行うことが困難であることから、平成 26 年 12 月期の通期業績予想は未定といたしました。通期業績予想は合理的な予想が可能となった時点で速やかに公表いたします。

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債、純資産の状況

当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 5,188 百万円増加し、498,522 百万円となりました。償却の進行・長期前渡金の取り崩し等により固定資産が 12,329 百万円減少し、また、譲渡性預金の償還により有価証券が 5,500 百万円減少した一方で、長期供給契約に基づく原材料の購入等により原材料及び貯蔵品が 30,920 百万円増加したことがその主な要因であります。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ 9,322 百万円減少し、303,686 百万円となりました。長期借入金が 40,690 百万円増加した一方で、短期借入金が 36,198 百万円、リース債務が 5,597 百万円、及びその他の流動負債が 8,809 百万円減少したことがその主な要因であります。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ 14,510 百万円増加し、194,836 百万円となりました。円安に伴い為替換算調整勘定が 6,943 百万円増加したこと、及び少数株主持分が 5,205 百万円増加したことがその主な要因であります。

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9,240百万円減少し、62,863百万円となりました。これは、営業活動によるキャッシュ・フローが2,341百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△8,735百万円、及び財務活動によるキャッシュ・フローが△4,513百万円となったこと等によるものであります。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度の営業活動キャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ13,966百万円減少し、2,341百万円となりました。これは、税金等調整前当期純利益が改善された一方で、減価償却費の減少によりキャッシュ・フローが悪化したことが主な要因であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度の投資活動キャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ支出が6,492百万円減少し、△8,735百万円となりました。これは、有形及び無形固定資産の取得による支出が減少したことが主な要因であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当連結会計年度の財務活動キャッシュ・フローは、△4,513百万円となりました。これは長期借入れによる収入が97,650百万円であった一方、長期借入金の返済による支出が△55,011百万円、短期借入金の純増減額が△39,769百万円、リース債務の返済による支出が△8,640百万円であったことが主な要因であります。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成22年1月期	平成23年1月期	平成24年1月期	平成25年1月期	平成25年12月期
自己資本比率 (%)	39.9	35.0	25.1	32.2	33.7
時価ベースの自己資本比率 (%)	60.6	57.4	38.6	49.6	48.0
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	38.9	9.1	12.4	14.7	102.0
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	1.9	6.1	4.9	4.9	0.7

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１） いずれも連結ベースの財務諸表により計算しております。

（注２） 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注３） キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。

（注４） 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。

（注５） 平成25年12月期は決算期変更に伴い、11ヶ月の変則決算となっております。

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社の剰余金の配当に関する基本方針は、各事業年度における利益水準、次期以降の見通し、設備投資に係る資金需要及び内部留保の状況等を総合的に勘案した上で、決定していくこととしております。

なお、当期の普通株式期末配当金につきましては、１株当たり１円を予定しております。また、平成26年12月期の普通株式配当予想につきましては、現時点においては未定とさせていただきます。

（4）事業等のリスク

当社グループは、以下のような事項を当社グループの経営並びに事業遂行上の主要なリスク要因と認識しており、その発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、これらの要因により、当社グループの事業、経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。

なお、以下の事項のうち将来に関する事項は、提出日現在において当社グループが判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

① 事業環境について

当社グループが製造及び販売するシリコンウェーハは、各種半導体の基板等に用いられるものであることから、半導体及びその周辺産業等に特徴的な諸要因の影響を受けることがあります。かかる諸要因には、半導体業界における急激な市況悪化、半導体及びその周辺産業等における急速な技術革新の進展、製品の陳腐化、製品構成の急速な変化、製品価格の下落、特定顧客との取引の集中とその特定顧客からの受注の大幅な変動、同業他社との競争優位性の変化に伴う当社グループの競争力の変動、及び顧客需要の大きな振幅等があり、これらは当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

② 当社グループの製品について

当社グループの製品が用いられる半導体の価格は、製品の市場投入後は普及による販売数量拡大等の影響もあり、一般的に低下する傾向にあります。当社グループにおいては、量産化による販売数量の拡大や製造工程等における歩留率向上等の合理化を進めることにより、当該製品価格低下を想定した事業計画を策定しておりますが、急激な市況悪化その他の事由により想定以上の販売価格低下が生じる場合、当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

なお、上記以外にも、品質の不適合（具体的には、当社グループが顧客に納入した製品について、顧客の要求規格及び仕様等を充足しない場合、または不適合等が生じる場合に重大な品質クレームを引き起こす可能性）、生産性向上の未達成等（具体的には、製品製造工程における歩留率改善等による継続した生産効率の向上が図られない場合の利益の圧迫要因、もしくは製造設備の事故やその他の要因による製造の中断、あるいは大幅な遅延等が生じる場合に、当社グループ全体の生産能力低下や特定製品の供給が困難となる可能性等）が当社グループの経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

③ 原材料の調達について

シリコンウェーハの主要原材料は、極めて純度の高い多結晶シリコンであり、製造者が限定されていることから、供給不安のリスクがあります。そのため、当社グループは、世界の主要な多結晶シリコンメーカーとの間で、多結晶シリコンメーカーが一定期間に一定の数量を供給し、当社グループが購入する旨の長期購入契約を締結し、原材料の安定調達を図ってまいりました。しかしながら、市場の急激な変化に伴い、長期購入契約締結時の需要予想と足元の消費見通しに乖離が生じており、在庫が増加しております。

原材料在庫を含む「原材料及び貯蔵品」の増加見通しについては、「３．経営方針（３）会社の対処すべき課題」に記載した通りでありますが、事業環境の著しい変化等により、消費量が変動した場合、あるいは、会計上の対応が必要となる場合、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

④ 主要製造設備の安定調達について

当社の主要製造設備には、当社と設備機器メーカーとの間で共同開発した両面研磨機等、他メーカーへの切り替えができない設備があります。これらの円滑な調達が困難な場合には、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 顧客及びサプライヤーに係るリスク（経営破綻・操業停止等）について

当社グループは、顧客の与信管理には万全を期しておりますが、仮に顧客が倒産し、多額の売上債権が回収不能となる場合、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。また、当社は

諸資材の調達については、複数のメーカーと契約する等、調達途絶リスクを回避する施策を講じておりますが、経済環境の急激な悪化やサプライヤーの設備事故等による操業停止あるいは倒産等により、諸資材等の調達に支障を来たす場合、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼす可能性があります。

⑥ 設備投資について

当社グループは中長期的な需要予測に基づいて設備投資を実施しておりますが、経済動向や半導体業界を取り巻く環境の変化により、需要予測に大幅な変化が生じる場合には、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑦ 資金調達について

当社グループのシンジケート・ローン契約等につきましては、財政状況の著しい悪化により、その財務制限条項に抵触し、当該借入金について返還請求を受けた場合には、期限の利益を失い、当社グループの資金調達に影響を及ぼす可能性があります。

⑧ 技術及び研究開発について

半導体業界は、急速な技術革新が進む業界であり、半導体の高集積化、細密化や半導体用途の多様化、高精度化及び生産効率の向上等、当社グループのシリコンウェーハに対して顧客より要求される各種技術は多岐に亘り、且つ、高度化しております。当社グループは、かかる顧客からの要求に応えるため、中長期的に需要の拡大が見込まれる300㎜ウェーハに関する技術、品種別ではエピタキシャルウェーハやアニールウェーハ等の高付加価値ウェーハ関連技術、さらに、次世代ウェーハ製品の関連技術等に重点をおいた研究開発活動を行っております。

しかしながら、業界における技術進歩への対応に支障が生じ、顧客の要求に適合することが困難となり、研究開発活動が想定した効果を得られない場合には、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑨ 知的財産権について

当社グループは、シリコンウェーハ業界において競合他社に対抗していくためには、特許権その他の知的財産権の確保が非常に重要であると認識しており、国内外において出願中のものを含めて多数の特許を保有しております。

また、当社グループは、大重量結晶の製造、無欠陥結晶、高精度の両面研磨技術等に関する基本特許を保持しておりますが、さらに、これら特許から発展した技術及び周辺技術についても特許の出願を進めております。

しかしながら、当社グループが認識しない第三者の特許が既に成立している場合において、当該第三者より知的財産権を侵害しているとの事由により、使用差止及び損害賠償等の訴えを起こされる場合、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑩ 海外展開について

当社グループは、全世界の主要な半導体メーカー等に対してシリコンウェーハを供給しておりますが、生産及び販売活動については、日本国内に加えて、北米、欧州及びアジアにそれぞれ拠点を設置し事業を展開しております。当社グループのこれらの生産及び販売活動には、為替変動リスクがあるほか、各国及び各地域等の経済情勢、政治情勢、法規制、税制、為替規制等の変化による影響や、現地での紛争、テロや災害の発生、感染症の流行、社会・労働慣行の相違、社会的インフラの未整備等による影響を受ける可能性があります。

⑪ 環境規制等について

当社グループの事業は、主に製造拠点において、エネルギーの使用、排気、排水、有害化学物質の使用及び保管、産業廃棄物の廃棄、土壌及び地下水の汚染の検査及び浄化等、環境に関する多くの国内外の法的規

制を受けており、これらの規制に基づき一定の費用負担や賠償義務その他法的責任が生じる可能性があります。また、近年においては、一般的にこれら環境等に関する規制は強化される傾向にあります。今後において環境等に関する新たな国内外の法規制等が制定される可能性は否定できず、そのような場合、当社グループにおいて、これら法規制等への対応のために新たな費用負担等が生じることが予想され、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑫ 自然災害、事故等のリスクについて

当社グループの各製造拠点において、台風、豪雨、地震、津波または火山活動等の自然災害や、事故、火災、テロ等により、生産の停止、設備の損壊や給水・電力供給の制限等の不測の事態が発生する場合には、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

特に、当社グループの主力商品である300㎜ウェーハの加工工程を有する製造拠点が、上記の自然災害、事故、火災等に見舞われる場合、300㎜ ウェーハの製造・販売に支障を来たし、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑬ 企業買収に関するリスクについて

当社は、企業買収の実施に当たり、当該企業の財務内容等についてデューデリジェンスを行い、事前にリスク回避するように努めておりますが、事業環境の急激な変化等、不測の事態が生じる場合、当社グループの事業展開、経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑭ 上記以外のリスクについて

当社グループは、事業環境の変化等により、以下のような事態が生じる場合、当社グループの経営成績、財政状態等に影響を及ぼすことがあります。

a. 事業環境の大幅な変化により事業及び組織の再構築等が必要となる事態が生じる場合。
b. 退職給付債務に関して、今後当社の年金資産の時価の下落、運用利回りの低下、または退職給付債務を計算する数理計算上の前提条件の大幅な変化が生じる場合。
c. 経済環境の変化等により、将来の収益等の見積りが大幅に変動する等、会計上の対応が必要となる場合。
d. 外部環境の変化等により当社グループが想定する以上の資金需要が生じる場合、あるいは金融機関との契約により期限の利益を喪失する場合、また、金利水準や市場環境等の要因により当社グループが希望する時期または条件により資金調達が実行できない場合。

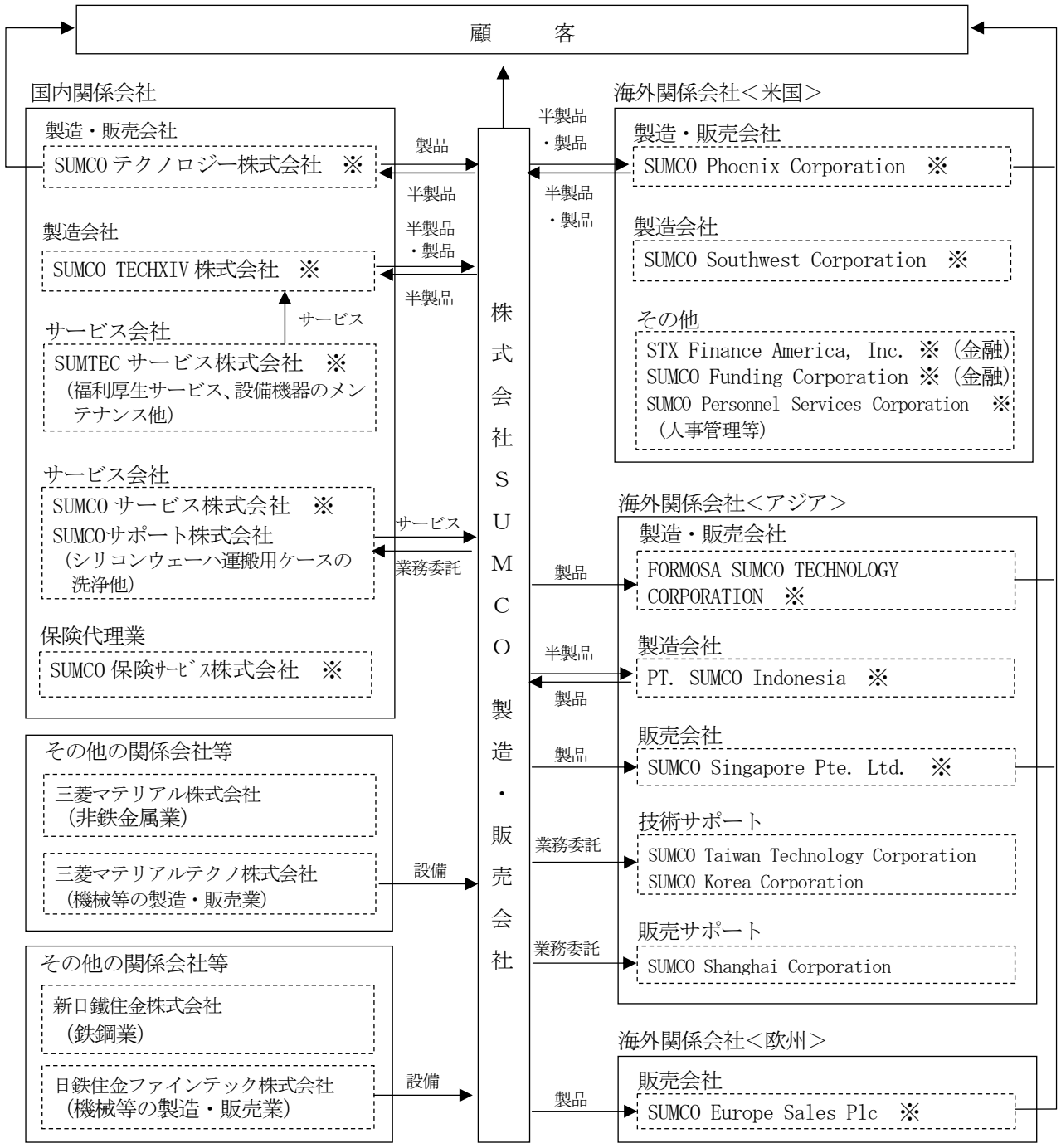
２．企業集団の状況

当社の関係会社は国内子会社７社（連結子会社５社、非連結子会社２社）及び海外子会社１２社（連結子会社９社、非連結子会社３社）であります。また、当社のその他の関係会社は新日鐵住金株式会社と三菱マテリアル株式会社であり、当社は当該両社のグループに属しております。

当社と当社の子会社で構成されるグループ（以下「当社グループ」といいます。）の事業は「高純度シリコン事業」のみであります。

［事業系統図］

以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。（※は連結子会社）



当連結会計年度において、SUMCO ソーラー株式会社を清算し、SUMCO 保険サービス株式会社を設立いたしました。

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

当社グループは「お客様と株主の期待に応え、従業員に幸せを与え、社会に貢献する、常に世界一のシリコンウェーハメーカーを目指す」という経営理念のもと、半導体デバイスに使用される高品質のシリコンウェーハ製造において、大口径から小口径までカバーする幅広い製品展開力と技術力を有し、これらを最大限に活用し安定的な供給体制を構築することにより、社会の発展に貢献してまいります。特に、顧客からの極めて厳しい品質・コスト要求に応える技術力の向上に傾注し、シリコンウェーハ業界における地位の維持・向上を図ってまいります。

当社グループは、この基本方針のもと、事業基盤を更に強化し、事業の持続的成長を目指し、ステークホルダーの負託に応えてまいる所存であります。

（２）中長期的な会社の経営戦略

半導体シリコンウェーハのうち300㎜ウェーハは、変動要因はあるものの半導体市場の需要伸張とともに拡大していく見通しであります。200㎜以下のウェーハは300㎜ウェーハへの移行もあり需要が徐々に低下していく見通しであります。

このような環境の中、主力製品である300㎜ウェーハについては、高精度化・微細化の要求や需要拡大に適宜対応してまいります。200㎜以下のウェーハについては、設備規模の適正化を図るべく生産体制の再編を遂行し、集中生産と高効率操業を実現してまいりました。また、コスト競争力の強化に加え、パワー半導体向け等今後の需要拡大が期待される製品の強化を図り、収益性の改善に努めてまいります。

また、シリコンウェーハは、経営環境の変化が大きい製品であるため、引き続き損益分岐点の引き下げに加え、需要環境の変化に迅速かつ適正に対応できる企業体質の構築を図ってまいります。

（３）会社の対処すべき課題

当社グループでは、平成24年２月に発表いたしました ①ソーラー事業からの撤退、②需要の減少が見込まれる小径事業を主体とした生産拠点の更なる再編によるコスト競争力の維持・強化、③これら生産体制の最適化に対応した希望退職の募集を主な内容とする要員体制の見直しを骨子とする「事業再生計画」を完遂すると共に、投資の効率化や更なる間接費の圧縮等による合理化を強力に推進し、当連結会計年度は昨年度に引き続き２期連続の黒字を計上いたしました。

しかしながら、世界経済には依然として不透明感が強いことなど、今後の事業環境については予断を許さない状況にあります。係る状況下、事業環境の変化に対応した施策を適宜実行することにより、さらなる収益基盤の強化及び持続的成長の実現に向け変革を進めてまいります。

なお、シリコンウェーハの主要原材料である多結晶シリコンにつきましては、市場の急激な変化に伴い、長期購入契約締結時の需要予測と足元の消費見通しに乖離が生じていることから、現在余剰在庫を保有しており、原材料在庫を含む「原材料及び貯蔵品」の残高は、対前年度末比、309億円増加の1,157億円となっております。

「原材料及び貯蔵品」の残高は、平成26年12月期期末には、おおよそ1,300億円強まで増加する見込みでありますが、今後、徐々に長期購入契約の契約期間満了を迎えることから、毎年の増加幅は漸減傾向にあり、平成28年度頃にピークを迎えた後、減少に転ずる見通しであります。

中長期的には適正水準に回復する見込みでありますが、今後も原材料在庫の適正水準への早期回復に向けて、努力してまいります。

４．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

（単位：百万円）

	前連結会計年度 （平成25年１月31日）	当連結会計年度 （平成25年12月31日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	35,103	31,363
受取手形及び売掛金	32,457	30,806
有価証券	37,000	31,500
商品及び製品	17,030	14,750
仕掛品	11,229	12,189
原材料及び貯蔵品	84,798	115,719
繰延税金資産	161	149
その他	9,091	7,791
貸倒引当金	△131	△11
流動資産合計	226,741	244,259
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	190,304	193,796
減価償却累計額	△94,815	△100,992
建物及び構築物（純額）	95,488	92,804
機械装置及び運搬具	723,436	707,616
減価償却累計額	△676,887	△655,640
機械装置及び運搬具（純額）	46,549	51,976
土地	20,235	20,279
建設仮勘定	16,328	8,133
その他	13,798	13,717
減価償却累計額	△13,039	△13,116
その他（純額）	759	600
有形固定資産合計	179,360	173,794
無形固定資産		
のれん	15,231	13,573
ソフトウエア	2,365	2,090
その他	248	198
無形固定資産合計	17,844	15,862
投資その他の資産		
投資有価証券	118	119
長期前渡金	58,094	54,306
長期前払費用	3,991	3,434
繰延税金資産	5,925	5,623
その他	1,628	1,519
貸倒引当金	△370	△396
投資その他の資産合計	69,387	64,606
固定資産合計	266,592	254,263
資産合計	493,334	498,522

（単位：百万円）

	前連結会計年度 （平成25年１月31日）	当連結会計年度 （平成25年12月31日）
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	28,658	29,952
短期借入金	125,308	89,110
リース債務	9,074	3,727
未払法人税等	236	477
賞与引当金	2,171	2,016
設備関係支払手形及び設備関係未払金	2,332	1,259
その他	17,506	8,696
流動負債合計	185,287	135,238
固定負債		
長期借入金	103,150	143,841
リース債務	2,410	2,159
繰延税金負債	512	895
再評価に係る繰延税金負債	1,559	1,559
退職給付引当金	17,544	17,505
その他	2,542	2,486
固定負債合計	127,721	168,447
負債合計	313,008	303,686
純資産の部		
株主資本		
資本金	136,607	136,607
資本剰余金	15,676	15,676
利益剰余金	16,849	15,924
自己株式	△8	△9
株主資本合計	169,124	168,198
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	0	0
繰延ヘッジ損益	△3,431	－
土地再評価差額金	2,671	2,671
為替換算調整勘定	△9,618	△2,675
在外子会社の退職給付債務調整額	－	△143
その他の包括利益累計額合計	△10,378	△147
少数株主持分	21,579	26,785
純資産合計	180,325	194,836
負債純資産合計	493,334	498,522

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）

【連結損益計算書】

（単位：百万円）

	前連結会計年度 （自　平成24年２月１日 至　平成25年１月31日）	当連結会計年度 （自　平成25年２月１日 至　平成25年12月31日）
売上高	206,691	185,105
売上原価	169,895	147,965
売上総利益	36,795	37,140
販売費及び一般管理費	23,579	19,338
営業利益	13,215	17,801
営業外収益		
受取利息	34	29
受取配当金	141	16
固定資産売却益	80	41
助成金収入	941	449
その他	570	276
営業外収益合計	1,768	813
営業外費用		
支払利息	3,237	3,168
為替差損	680	6,064
固定資産除売却損	133	278
シンジケートローン手数料	14	1,490
その他	1,454	548
営業外費用合計	5,520	11,550
経常利益	9,464	7,065
特別利益		
受取補償金	1,391	－
退職給付信託設定益	319	－
特別利益合計	1,711	－
特別損失		
事業構造改善費用	7,271	2,672
特別損失合計	7,271	2,672
税金等調整前当期純利益	3,903	4,392
法人税、住民税及び事業税	302	395
法人税等調整額	△1,066	1,715
法人税等合計	△763	2,111
少数株主損益調整前当期純利益	4,667	2,281
少数株主利益	1,240	1,566
当期純利益	3,426	715

（連結包括利益計算書）

【連結包括利益計算書】

（単位：百万円）

	前連結会計年度 （自　平成24年２月１日 至　平成25年１月31日）	当連結会計年度 （自　平成25年２月１日 至　平成25年12月31日）
少数株主損益調整前当期純利益	4,667	2,281
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△149	0
繰延ヘッジ損益	△3,441	3,431
為替換算調整勘定	7,475	10,848
在外子会社の退職給付債務調整額	－	△279
その他の包括利益合計	3,885	14,000
包括利益	8,552	16,281
（内訳）		
親会社株主に係る包括利益	4,339	10,946
少数株主に係る包括利益	4,213	5,335

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自平成24年２月１日　至平成25年１月31日）

（単位：百万円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	114,107	89,291	△82,692	△8	120,697
当期変動額					
新株の発行	22,500	22,500			45,000
欠損填補		△96,115	96,115		－
剰余金の配当					
当期純利益			3,426		3,426
土地再評価差額金の取崩			0		0
自己株式の取得				△0	△0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	22,500	△73,615	99,542	△0	48,427
当期末残高	136,607	15,676	16,849	△8	169,124

	その他の包括利益累計額						少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	為替換算調整勘定	在外子会社の退職給付債務調整額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	149	10	2,671	△14,121	－	△11,290	17,366	126,773
当期変動額								
新株の発行								45,000
欠損填補								－
剰余金の配当								
当期純利益								3,426
土地再評価差額金の取崩			△0			△0		－
自己株式の取得								△0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△149	△3,441		4,503		912	4,213	5,125
当期変動額合計	△149	△3,441	△0	4,503	－	912	4,213	53,552
当期末残高	0	△3,431	2,671	△9,618	－	△10,378	21,579	180,325

当連結会計年度（自平成25年２月１日　至平成25年12月31日）

（単位：百万円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	136,607	15,676	16,849	△8	169,124
当期変動額					
新株の発行					
欠損填補					
剰余金の配当			△1,640		△1,640
当期純利益			715		715
土地再評価差額金の取崩			0		0
自己株式の取得				△0	△0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	－	－	△925	△0	△925
当期末残高	136,607	15,676	15,924	△9	168,198

	その他の包括利益累計額						少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	為替換算調整勘定	在外子会社の退職給付債務調整額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	0	△3,431	2,671	△9,618	－	△10,378	21,579	180,325
当期変動額								
新株の発行								
欠損填補								
剰余金の配当								△1,640
当期純利益								715
土地再評価差額金の取崩			△0			△0		－
自己株式の取得								△0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	0	3,431		6,943	△143	10,231	5,205	15,436
当期変動額合計	0	3,431	△0	6,943	△143	10,230	5,205	14,510
当期末残高	0	－	2,671	△2,675	△143	△147	26,785	194,836

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

	前連結会計年度 （自　平成24年２月１日 至　平成25年１月31日）	当連結会計年度 （自　平成25年２月１日 至　平成25年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	3,903	4,392
減価償却費	32,333	21,024
のれん償却額	1,636	1,657
受取補償金	△1,391	－
事業構造改善費用	2,765	2,672
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△41	△125
賞与引当金の増減額（△は減少）	△329	△250
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△438	△537
受取利息及び受取配当金	△176	△46
支払利息	3,237	3,168
固定資産除売却損益（△は益）	52	236
売上債権の増減額（△は増加）	4,973	3,678
たな卸資産の増減額（△は増加）	△34,383	△27,055
その他の流動資産の増減額（△は増加）	3,005	1,807
仕入債務の増減額（△は減少）	784	△1,208
その他の流動負債の増減額（△は減少）	149	△5,513
その他	3,737	1,904
小計	19,820	5,806
利息及び配当金の受取額	151	46
利息の支払額	△3,301	△3,289
法人税等の支払額	△361	△222
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,308	2,341
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形及び無形固定資産の取得による支出	△16,276	△8,399
有形固定資産の売却による収入	67	147
子会社株式の取得による支出	△5	－
その他	985	△483
投資活動によるキャッシュ・フロー	△15,228	△8,735
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,015	△39,769
長期借入れによる収入	39,000	97,650
長期借入金の返済による支出	△29,718	△55,011
セール・アンド・リースバックによる収入	－	3,029
リース債務の返済による支出	△9,560	△8,640
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	－	△1,640
少数株主への配当金の支払額	－	△130
株式の発行による収入	44,766	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	47,502	△4,513
現金及び現金同等物に係る換算差額	367	1,668
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	48,950	△9,240
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△2,310	－
現金及び現金同等物の期首残高	25,464	72,103
現金及び現金同等物の期末残高	72,103	62,863

（５）連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

前連結会計年度（自平成24年２月１日　至平成25年１月31日）及び当連結会計年度（自平成25年２月１日　至平成25年12月31日）

当社グループは「高純度シリコン事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

ｂ．関連情報

前連結会計年度（自平成24年２月１日　至平成25年１月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

（単位：百万円）

日本	北米	アジア	欧州他	合計
68,395	31,152	92,497	14,645	206,691

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

（単位：百万円）

日本	アジア	その他	合計
134,320	40,866	4,173	179,360

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
Samsung Electronics Co., Ltd	29,656	高純度シリコン
住友商事株式会社	28,642	高純度シリコン

当連結会計年度（自平成25年2月1日　至平成25年12月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1) 売上高

（単位：百万円）

日本	北米	アジア	欧州他	合計
49,356	29,595	90,522	15,630	185,105

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

（単位：百万円）

日本	アジア	その他	合計
123,885	45,347	4,560	173,794

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
Samsung Electronics Co., Ltd	20,884	高純度シリコン
住友商事株式会社	19,690	高純度シリコン

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

前連結会計年度（自平成24年2月1日　至平成25年1月31日）及び当連結会計年度（自平成25年2月1日至平成25年12月31日）

該当事項はありません。

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

前連結会計年度（自平成24年2月1日　至平成25年1月31日）及び当連結会計年度（自平成25年2月1日至平成25年12月31日）

当社グループの事業は「高純度シリコン」のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

前連結会計年度（自平成24年2月1日　至平成25年1月31日）及び当連結会計年度（自平成25年2月1日至平成25年12月31日）

該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前連結会計年度 （自　平成24年２月 １日 至　平成25年１月31日）		当連結会計年度 （自　平成25年 ２月 １日 至　平成25年12月31日）	
１株当たり純資産額	436円94銭	１株当たり純資産額	473円 42銭
１株当たり当期純利益金額	8円93銭	１株当たり当期純損失金額（△）	△1円 22銭

（注）１．当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失金額であるため記載しておりません。なお、前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 （自　平成24年２月 １日 至　平成25年１月31日）	当連結会計年度 （自　平成25年 ２月 １日 至　平成25年12月31日）
１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△)		
当期純利益金額（百万円）	3,426	715
普通株主に帰属しない金額（百万円）	1,125	1,029
（うち優先配当額（百万円））	(1,125)	(1,029)
普通株主に係る当期純利益金額又は当期純損失金額（△）（百万円）	2,301	△314
普通株式の期中平均株式数（株）	257,746,762	257,746,136
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	A種種類株式 450株	――――

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

５．その他

（１）役員の異動

① 代表取締役の異動

該当事項はありません。

② その他の役員の異動

・新任取締役候補

（非常勤）取締役　太田 啓武　（現　三菱マテリアル株式会社
電子材料事業カンパニーシリコン事業部
多結晶製品技術・管理部長）

（非常勤）取締役　三冨 正博　（現　株式会社バリュークリエイト代表取締役）

（注）太田 啓武及び三冨 正博は社外取締役の候補者であります。

・退任予定取締役

（非常勤）取締役　宮原 弘法

（非常勤）取締役　住田 昌弘

・退任予定監査役

（非常勤）監査役　深澤 和臣

③ 就任予定日

平成 26 年 3 月 28 日

以　上